

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2007 年 8 月 30 日 (30.08.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/097022 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 7/02 (2006.01) *H01L 23/10* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/303600
- (22) 国際出願日: 2006 年 2 月 27 日 (27.02.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋 豊誠 (TAKAHASHI, Toyosei) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西 2 - 1 7 - 1 6 代官山 TKビル 1 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ADHESIVE FILM

(54) 発明の名称: 接着フィルム

(57) Abstract: An adhesive film for use to bond semiconductor parts and liquid crystal display parts to substrates. There is provided an adhesive film of 30 g/m² 24h or higher moisture permeability comprised of a resin composition containing a hardenable resin and a filler. The hardenable resin is preferably one containing a photohardenable resin, a thermosetting resin or a resin hardenable by not only light but also heat. The filler is one containing a porous filler, and the average pore diameter of the filler is preferably in the range of 0.1 to 5 nm. The moisture permeability at 25°C of the adhesive film is preferably 4 g/m² 24h or higher.

(57) 要約: 半導体用部品または液晶表示用部品と、基板とを接合するために用いられる接着フィルムであって、前記接着フィルムは、硬化性樹脂と、充填材とを含む樹脂組成物で構成され、かつ前記接着フィルムの透湿率が 30 [g/m²・24h] 以上である接着フィルムであり、前記硬化性樹脂は、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、並びに光および熱の両方で硬化可能な硬化性樹脂を含むものであることが好ましい。前記充填材は、多孔質充填材を含むものであり、前記充填材の平均空孔径は、0.1~5 nm、前記接着フィルムの 25°C での透湿率は、4 [g/m²・24h] 以上であることが好ましい。



WO 2007/097022 A1